



大阪市立大学  
兵庫県立大学  
大阪府立大学

プレスリリース

大阪科学・大学記者クラブ 御中

2014年7月22日

公立大学法人 大阪市立大学 大学広報室

TEL : 06-6605-3570 FAX : 06-6605-3572

Email : [t-koho@ado.osaka-cu.ac.jp](mailto:t-koho@ado.osaka-cu.ac.jp)

## 公立三大学共催 企業と博士人材の交流会 「インタラクティブ・マッチング」を開催します

大阪市立大学、兵庫県立大学、大阪府立大学の公立3大学は、平成26年8月22日（金）にグランフロント大阪におきまして、企業と博士人材の交流会：「インタラクティブ・マッチング（IM）」を開催いたします。本イベントは、文部科学省 科学技術人材育成費補助金によるポストドクター・キャリア開発事業「公立3大学 産業牽引型ドクター育成プログラム」の一環として、平成24年度より3大学が共同実施しているものです。

この交流会では、高度な専門能力を持つ若手博士人材が自己アピールを兼ねたプレゼンテーションを行います。その際、専門分野以外の方にも価値を理解いただけるよう、専門用語をなるべく使わずに発表します。企業の皆様にとっては、社内での活躍が期待できる高度人材の発掘の場になると同時に、参加者との質疑応答やディスカッションを通じて、同一分野についてはもちろんのこと、異なる分野の企業との技術融合による新たな価値創出を探求できる機会にもなり得ます。これまでに行ったIMから、企業との連携が多数生まれております。

また今回は、パナソニック株式会社 R&D 本部 先端技術研究所 グループマネージャーの山田由佳（やまだ ゆか）氏をお招きし、「材料技術が切り開くグリーンライフイノベーション」と題して、基調講演をいただきます。

産業界から多数のご参加をお待ちしております。

記

1. 日時：平成26年8月22日（金）13時～17時30分
2. 場所：グランフロント大阪 北館タワーB 10階 カンファレンスルーム  
（JR大阪駅より 徒歩約7分）
3. 発表テーマ分野：材料、化学、素材
4. 参加費：無料
5. 定員：96名（先着順）

## 6. プログラム：

1. 開会挨拶 桐山 孝信（きりやま たかのぶ）大阪市立大学 理事兼副学長
2. 基調講演  
「材料技術が切り開くグリーンライフイノベーション  
～心豊かなグリーンライフスタイルの実現をめざして～」  
パナソニック株式会社 R&D 本部 先端技術研究所  
エコマテリアル研究グループ グループマネージャー 山田 由佳 氏  
※日経 WOMAN 「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2014」リーダー部門受賞者
3. ポストドクターおよび博士課程学生の発表  
三木 祥平 兵庫県立大学 工学研究科 機械系工学専攻 D3  
結晶シリコン太陽電池の製造コスト削減  
～シリコン インゴット切削クズの再原料化～  
松本 祐樹 大阪市立大学 工学研究科 電子情報系専攻 PD  
有機分子性結晶をモデルとした理論的解析  
～二次元格子上的キャリア伝導のメカニズムを探る～  
岩瀬 賢治 大阪府立大学 理学系研究科 物理科学専攻 D3  
機能性磁気材料を目指した物性研究  
樽谷 直紀 大阪府立大学 工学研究科 物質・化学系専攻 D1  
層状複水酸化物を用いた多孔体材料の開発  
～バイオ燃料製造に向けて～  
西山 聖 大阪市立大学 工学研究科 化学生物系専攻 特任助教  
導電フィラーを充填した高分子複合材料の正の抵抗-温度特性  
～高分子の結晶性とポリマーブレンドの効果～  
吉村 友希 兵庫県立大学 物質理学研究科 化学分析学分野 D2  
超高速で高効率な細胞ペアリング方法の開発
4. ポスターセッション
5. 閉会挨拶 辻 洋（つじ ひろし） 大阪府立大学 理事兼副学長

## 7. お申込み方法：

添付チラシの申し込み欄に必要事項を記入の上、Fax で 06-6605-3665 までお申込みください。  
あるいは、氏名、所属、役職または学年、メールアドレス、電話/Fax 番号を明記の上、  
ohnaka@ado.osaka-cu.ac.jp 宛にメールにてお申し込みください。

## 8. 参考 HP：

ポストドクター・キャリア開発事業「公立3大学 産業牽引型ドクター育成プログラム」  
<http://www.pdc.osaka-cu.ac.jp/>

## 9. 添付資料： チラシ

### 【本件に関するお問合せ先】

公立大学法人大阪市立大学 ポストドクター・キャリア開発事業担当 大仲（おおなか）  
（公立3大学 産業牽引型ドクター育成プログラム 事務局）

TEL：06-6605-3663 Fax：06-6605-3665 E-mail：ohnaka@ado.osaka-cu.ac.jp